

平成18年9月期 決算説明会



Automobile Industry



I T Industry

Nov. 24, 2006

1/35



おかげさまでOBARAは東証第一部に直接上場しました
(平成18年8月28日付・コード6877)



上場通知書授与式



2/35

平成18年9月期 業績結果について

<連結>

平成18年9月期決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

	18/9期	17/9期	増減額	増減率
売上高	39,748	35,482	+4,266	+12.0%
売上総利益	12,119	10,964	+1,155	+10.5%
売上総利益率	30.5%	30.9%		△0.4P
販管費	7,276	6,579	+697	+10.6%
販管費率	18.3%	18.5%		△0.2P
営業利益	4,842	4,385	+457	+10.4%
営業利益率	12.2%	12.4%		△0.2P
経常利益	5,202	4,506	+696	+15.5%
経常利益率	13.1%	12.7%		+0.4P
当期純利益	3,633	3,082	+550	+17.9%
当期純利益率	9.2%	8.7%		+0.5P

■売上高の増加

<事業別>

抵抗→高止まり推移

平面→半導体業界の設備投資が
堅調に推移し、売上が大幅増

抵抗→△224百万円(17/9期比△1.2%)

平面→+4,351百万円(17/9期比+27.4%)

■売上総利益率は微減

<事業別>

抵抗→経費増・原材料高騰により
利益率減少平面→売上増による操業度アップ
で利益率改善

<連結>



平成18年9月期決算概要-②

連結損益計算書

■セグメント別損益

(単位 百万円)

	抵抗溶接	増減額	レーザー	増減額	平面研磨	増減額	合計	増減額
売上高	19,037	△224	474	+139	20,237	+4,351	39,748	+4,266
売上総利益	5,553	△590	132	+38	6,433	+1,706	12,119	+1,155
売上総利益率	29.2%	△2.7P	27.9%	△0.0P	31.8%	+2.0P	30.5%	△0.4P
販管費	3,685	+158	129	△9	3,462	+548	7,276	+697
販管費率	19.4%	+1.0P	27.3%	△14.2P	17.1%	△1.2P	18.3%	△0.2P
営業利益	1,868	△748	2	+48	2,971	+1,158	4,842	+457
営業利益率	9.8%	△3.8P	0.6%	+14.1P	14.7%	+3.3P	12.2%	△0.2P



* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

5/35

<連結>



平成18年9月期決算概要-③

連結損益計算書

■販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

	18/9期		17/9期		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	3,713	9.3%	3,393	9.6%	+319
減価償却費	484	1.2%	466	1.3%	+17
運送費	594	1.5%	556	1.6%	+38
旅費交通費	433	1.1%	428	1.2%	+4
研究開発費	320	0.8%	147	0.4%	+172
その他	1,731	4.4%	1,586	4.5%	+144
合計	7,276	18.3%	6,579	18.5%	+697
期末従業員数	1,543人		1,498人		45人増



6/35

<連結>

平成18年9月期決算概要-④



■営業外損益

スワップ利益 → 211百万円

●銅価格のスワップ取引と金利スワップ取引による利益

■法人税等

税効果適用後の実効税率 → 26.9% (17/9期 27.1%)

●子会社の欠損金等→△7.4% 連結子会社の税率差異→△7.1%



7/35

<連結>

平成18年9月期決算概要-⑤



連結貸借対照表

(単位 百万円)

資産	18/9期		17/9期		増減	負債純資産	18/9期		17/9期		増減
	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	24,972	67.2%	21,022	66.4%	+3,949	流動負債	13,669	36.8%	11,215	35.4%	+2,454
有形固定資産	8,941	24.1%	7,828	24.7%	+1,112	固定負債	1,992	5.4%	2,993	9.5%	△1,000
無形固定資産	226	0.6%	223	0.7%	+3	(有利子負債)	(4,334)	(11.7%)	(4,395)	(13.9%)	(△60)
投資等	3,025	8.1%	2,596	8.2%	+429	純資産	21,503	57.9%	17,461	55.1%	+4,041
合計	37,166	100.0%	31,670	100.0%	+5,495	合計	37,166	100.0%	31,670	100.0%	+5,495

<主な増減>

売掛債権 → 1,477百万円増 (18/9期 11,200百万円 17/9期 9,723百万円)
 たな卸資産 → 1,005百万円増 (18/9期 7,167百万円 17/9期 6,162百万円)
 未収入金 → 842百万円増 (18/9期 1,459百万円 17/9期 616百万円)
 買掛債務 → 1,081百万円増 (18/9期 6,420百万円 17/9期 5,339百万円)

売上及び受注が増加したことにより、売掛債権、たな卸資産、未収入金及び買掛債務が増加



8/35

平成19年9月期の予想と グループの展望

<連結>

連結会社の系統図



OBARA株式会社



抵抗溶接

平面研磨装置

レーザー溶接

スピードファム株式会社

OBARA CORP. USA
 小原（南京）機電有限公司
 小原（上海）有限公司
 韓国小原株式会社
 OBARA (THAILAND) CO., LTD.
 OBARA (MALAYSIA) SDN. BHD.
 洋光産業株式会社
 OBARA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.
 OBARA AUSTRALIA PTY. LTD.
 OBARA INDIA PRIVATE LTD.

佐久精機株式会社
 SPEEDFAM INC. (台湾)
 SPEEDFAM (INDIA) PVT LTD.
 SPEEDFAM MECHTRONICS (上海)
 SPEEDFAM CORPORATION (USA)
 SpeedFam (BVI) LTD.
 S/Fクリーンシステム株式会社
 SpeedFam NV/SA (ベルギー)

<連結>



平成19年9月期業績予想(通期連結)

(単位 百万円)

	19/9期予想	18/9期実績	増減額	増減率
売上高	40,000	39,748	+251	+0.6%
売上総利益	11,800	12,119	△319	△2.6%
売上総利益率	29.5%	30.5%		△1.0P
販管費	7,000	7,276	△276	△3.8%
販管費率	17.5%	18.3%		△0.8P
営業利益	4,800	4,842	△42	△0.9%
営業利益率	12.0%	12.2%		△0.2P
経常利益	5,100	5,202	△102	△2.0%
経常利益率	12.8%	13.1%		△0.3P
当期純利益	3,100	3,633	△533	△14.7%
当期純利益率	7.8%	9.2%		△1.4P



11/35

<連結>



平成19年9月期予想(上・下半期)

(単位 百万円)

	19/9期 上半期予想	前同期比	19/9期 下半期予想	前同期比
売上高	20,700	+797	19,300	△545
売上総利益	6,100	+7	5,700	△327
売上総利益率	29.5%	△1.1P	29.5%	△0.8P
販管費	3,500	+111	3,500	△387
販管費率	16.9%	△0.1P	18.1%	△1.5P
営業利益	2,600	△103	2,200	+60
営業利益率	12.6%	△1.0P	11.4%	+0.6P
経常利益	2,800	△156	2,300	+53
経常利益率	13.5%	△1.3P	11.9%	+0.6P
当期純利益	1,700	△368	1,400	△165
当期純利益率	8.2%	△2.2P	7.3%	△0.6P



12/35

<連結>



平成19年9月期業績予想(セグメント別)

(単位: 百万円)

	抵抗溶接	前同期比	レーザー	前同期比	平面研磨	前同期比	合計	前同期比
売上高	18,500	△537	530	+55	20,970	+732	40,000	+251
売上総利益	5,400	△153	150	+17	6,250	△183	11,800	△319
売上総利益率	29.2%	+0.0P	28.3%	+0.4P	29.8%	△2.0P	29.5%	△1.0P
販管費	3,630	△55	120	△9	3,250	△212	7,000	△276
販管费率	19.6%	+0.3P	22.6%	△4.7P	15.5%	△1.6P	17.5%	△0.8P
営業利益	1,770	△98	30	+27	3,000	+28	4,800	△42
営業利益率	9.6%	△0.2P	5.7%	+5.1P	14.3%	△0.4P	12.0%	△0.2P



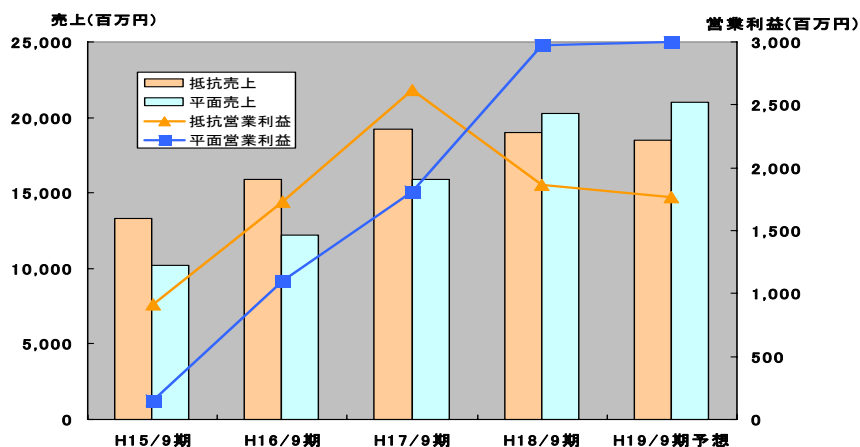
* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

13/35

<連結>



セグメント別業績の推移



14/35

<連結>



主な項目の実績と予想

(平成18年9月期実績) (平成19年9月期予想)

- ◆ 設備投資
1,972百万円 → 1,800百万円
- ◆ 減価償却費
1,017百万円 → 1,050百万円
- ◆ 研究開発費
567百万円 → 570百万円
- ◆ 為替想定レート
\$=116円 (1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)



注) 設備投資は有形無形を含む

15/35

<抵抗溶接>

抵抗溶接事業の概況



16/35

<抵抗溶接>

抵抗溶接事業 平成19年9月期業績予想

(単位: 百万円)

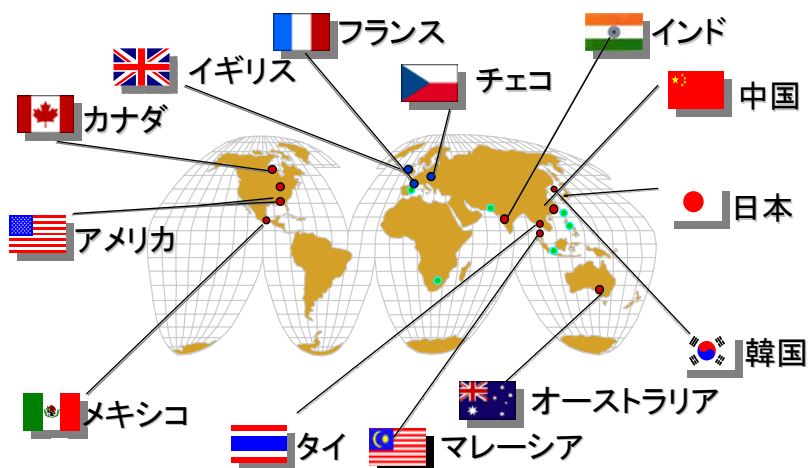
	19/9期 上半期予想	前同期比	19/9期 下半期予想	前同期比	19/9期 通期予想	前同期比
売上高	9,360	△247	9,140	△289	18,500	△537
売上総利益	2,820	△171	2,580	+18	5,400	△153
売上総利益率	30.1%	△1.0P	28.2%	+1.1P	29.2%	+0.0P
販管費	1,811	+54	1,818	△109	3,630	△55
販管費率	19.4%	+1.1P	19.9%	△0.5P	19.6%	+0.3P
営業利益	1,008	△226	761	+127	1,770	△98
営業利益率	10.8%	△2.1P	8.3%	+1.6P	9.6%	△0.2P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません



<抵抗溶接>

グローバル拠点網

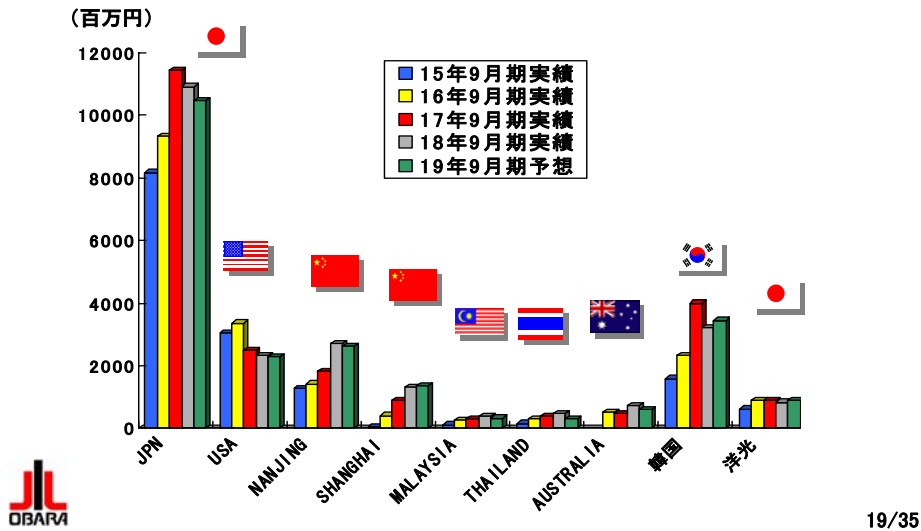


● 代理店: インドネシア・パキスタン・南アフリカ
 フィリピン・スペイン・台湾



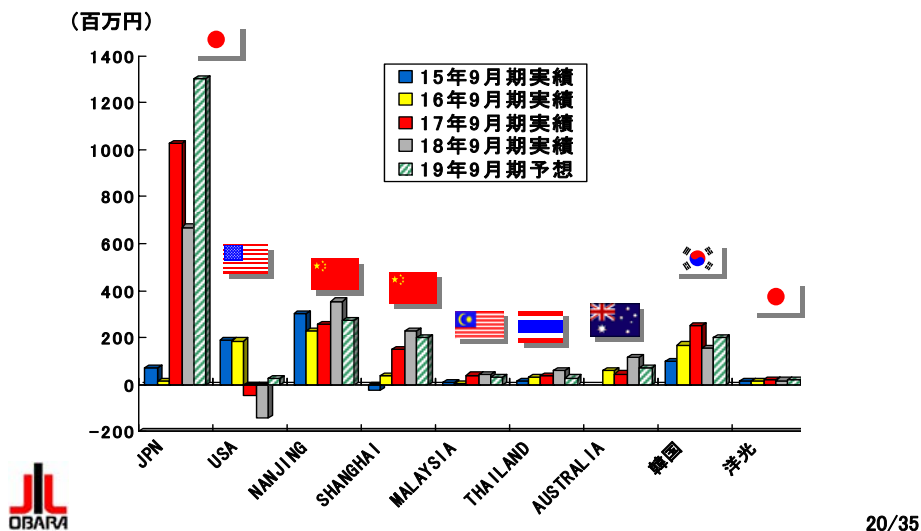
<抵抗溶接>

会社別の売上高予想と実績



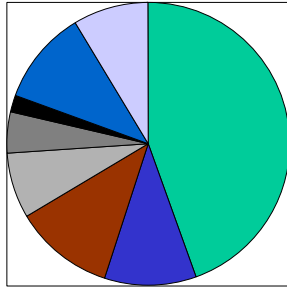
<抵抗溶接>

会社別の当期純利益実績と予想

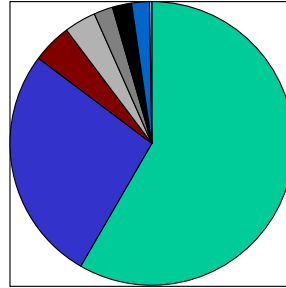


顧客基盤底上げへの取組

国内自動車メーカー別生産台数割合



当社国内自動車メーカー別売上割合



*生産台数「%」は、(社)日本自動車工業会の平成18年4月～9月の四輪車生産実績を参考

浜松出張所の開設準備



『スズキ様国内生産拠点』

2009年→国内生産124万台へ

<出張所の背景及び目的>

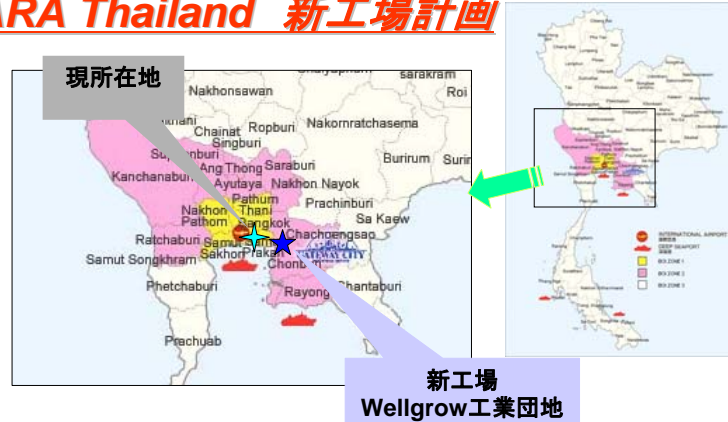
- ・スズキ様の生産規模拡大への対応
- ・出張所開設に伴い、短納期及びサポート体制の充実を図る



<抵抗溶接>

OBARA Thailand 新工場計画

Topics-②



	現工場	新工場
敷地 (m ²)	1,550	5,252
床面積 (m ²)	1,300	2,400
従業員数	43	50
売り上げ (百万パーツ)	140	200
売り上げ (百万円)	450	640



<背景>

- ・ 同国自動車生産量の急増
2010年に200万台水準へ

<目的>

- ・ 生産増加環境への取引先フォロー
体制の拡充

23/35

<平面研磨>



平面研磨事業の概況

- ▶ Siウエーハ顧客の力強い設備投資動向に
装置販売好調
- ▶ 顧客の生産活動拡大に伴い
消耗品販売が伸張
- ▶ 半導体デバイス顧客のエッジ関心への
提案製品エッジポリッシャー

SpeedFam

24/35

<平面研磨>



平面研磨事業 平成19年9月期業績予想

(単位 百万円)

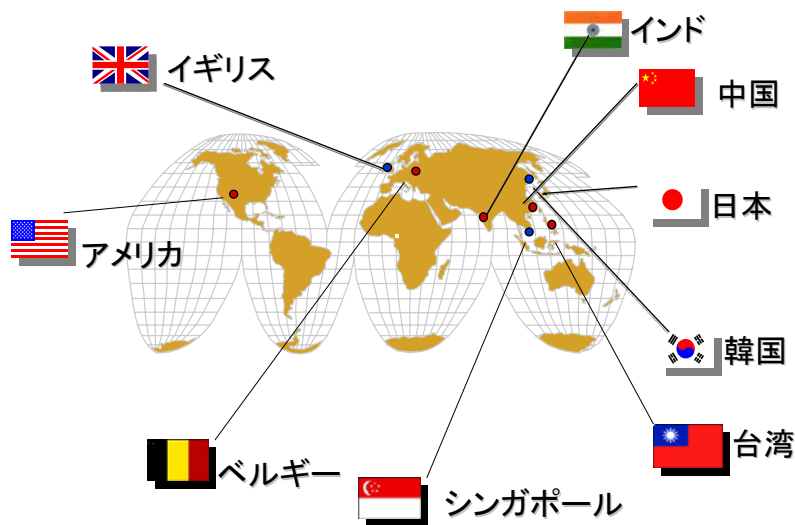
	19/9期 上半期予想	前同期比	19/9期 下半期予想	前同期比	19/9期 通期予想	前同期比
売上高	11,085	+979	9,885	△246	20,970	+732
売上総利益	3,210	+148	3,040	△331	6,250	△183
売上総利益率	29.0%	△1.3P	30.8%	△2.5P	29.8%	△2.0P
販管費	1,630	+63	1,620	△276	3,250	△212
販管費率	14.7%	△0.8P	16.4%	△2.3P	15.5%	△1.6P
営業利益	1,580	+84	1,420	△55	3,000	+28
営業利益率	14.3%	△0.5P	14.4%	△0.2P	14.3%	△0.4P

* 上記は参考数値であり、正式な開示数値ではありません

<平面研磨>



グローバル拠点網



<平面研磨>



商品群

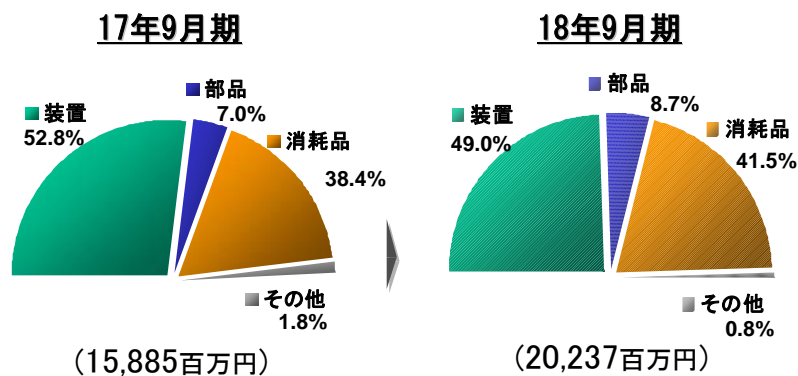
- ▶ 両面研磨装置、片面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置（エッジポリッシャー）
- ▶ 洗浄装置
- ▶ ドライエッチャー装置（DCP）
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

27/35

<平面研磨>



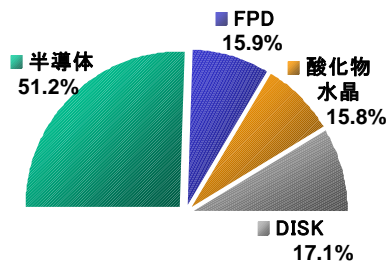
セグメント情報 — 商品別売上構成比 —



28/35

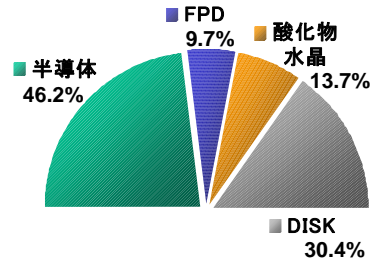
セグメント情報 — アプリケーション別売上構成比 —

17年9月期



(15,885百万円)

18年9月期



(20,237百万円)

平成18年9月期の傾注項目の結果

- 次世代平坦度を実現する両面研磨装置の展開
シリコンウェーハ各社から 装置受注

売上計上37億円と受注残高37億円

- 半導体デバイス工程向けエッジポリシャー
「EPD-X シリーズ」の提案

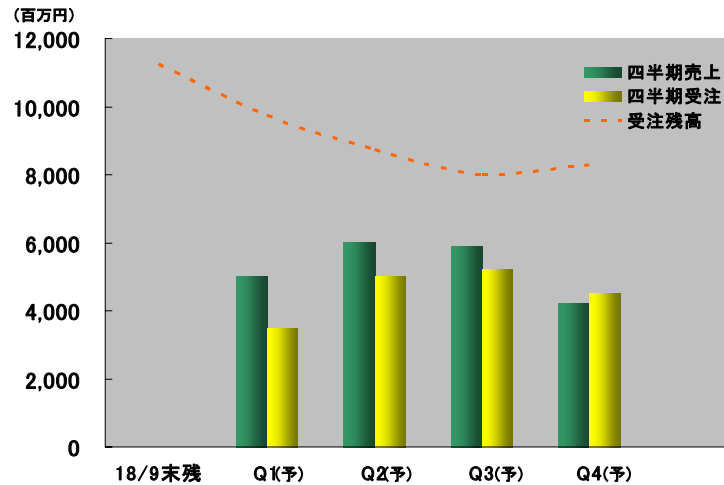
売上計上 3台

受注残高 1台

<平面研磨>



受注残高の推移予測



31/35

<平面研磨>



SPEEDFAMグループとして

- > 300mmシリコンウェーハ市場等への
 メイン・ラインナップ製品に注力
 製造能力アップへ：設備投資 3億円
- > 消耗副資材の販売強化
- > 半導体デバイス市場への提案
- > マーケットニーズへの継続的な活動
 研磨装置のモデル拡充：研究開発 2億円

32/35

佐久精機(株)／工場の拡張



33/35

<平面研磨>

投資の骨子

<工場の概要>

所在地：長野県佐久市菫蒲澤
土地面積：16,971㎡
工場面積：2,016㎡
竣工時期：平成18年7月

<投資内容>

建物：244百万円
機械：78百万円
合計：322百万円

<投資目的>

世界規模で進化と拡大を続けるIT産業の動向を踏まえ、スピーディーな受注補完を行うべく、生産能力30%向上を実施。

<工場建設による生産能力>

現在の生産能力 4,200百万円（年間ベース）
投資後の生産能力 5,500百万円（年間ベース）

34/35

<連結>



OBARAグループのVISION

■ *Niche市場において*
.....
世界一の
.....
企業集団にする
.....



35/35



<http://www.obara.co.jp>